



Technical Data Sheet

FeedBond® SP-2000A-SFB3/B4/B5

導電銀漿

A. 產品說明

FeedBond® SP-2000A-SFB3~B5 是一種高效能慢乾型無鹵素導電銀漿，能提供極佳的彎折性、附著性、硬度與阻抗值，可廣泛應用於薄膜開關、電腦鍵盤線路等軟板線路與硬板線路製作，且絲網印刷具有良好印刷性。

B. 產品特性

- 銀灰色漿狀
- 低電阻、硬度佳
- 附著性、彎折性佳
- 符合 RoHS 規範 ; Halogen free

C. 產品規格

固化前特性	單位	規格	量測值			檢測方式
			SP-2000A-SFB3	SP-2000A-SFB4	SP-2000A-SFB5	
黏度 (5 rpm)	cps	5000~15000	9141	9373	9295	Brookfield DV-III /CP-51 @25°C
固含量	%	55~70	59.71	60.2	59.87	烘箱烘烤 150°C/60min
固化溫度	°C	150		150		烘箱烘烤
固化時間	min	60		60		烘箱烘烤

固化後特性	單位	規格	量測值			檢測方式
			SP-2000A-SFB3	SP-2000A-SFB4	SP-2000A-SFB5	
附著性	-	4B	4B	4B	4B	百格測試 (3M 膠帶#600)
硬度	(荷重 1KG)	≥2H	2H	2H	2H	ASTM D3363
表面電阻	mΩ/□/mil	≤15	2.69	2.23	2.45	ASTM D257-78
彎折性	($\Delta R/R < 300\%$) ¹	≥12 次	≥12 次, $\Delta R/R = 82.5\%$	≥12 次, $\Delta R/R = 87.4\%$	≥12 次, $\Delta R/R = 95.5\%$	-

*備註 1: 荷重 3Kg 砝碼正反各壓 1 分鐘, 阻抗值升高不超過原來 300%

*備註 2: 以上固化條件僅為建議，固化條件可能會因為客戶的使用方式及固化設備等而有所不同

*備註 3: 電阻可客製化



D. 作業事項

- 作業方式:建議先將漿料攪拌均勻再進行印刷。
- 建議絲印參數:

漿料攪拌時間	10~15min, speed 200~300 rpm
絲網類型	聚酯絲網或不銹鋼絲網
網目	150~200 mesh
印刷厚度	8~12 um

- 清洗方式：建議以 DBE 與丙酮交互使用清潔印刷器具。

E. 基本訊息

1. 使用條件與實際數值仍依客戶使用環境與程序為準。
2. 使用該產品前須將基材表面清潔乾淨。

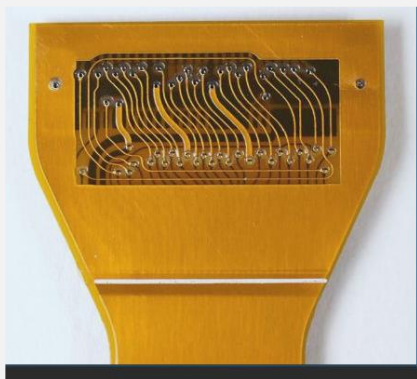
F. 貯存

1. 將本油墨放置於密封容器中，儲存溫度0~5°C(冷藏最好)。
2. 從容器中取出的產品在使用過程可能被汙染，請勿將使用過的產品倒回原容器。
3. 儲存壽命6個月。

G. 包裝

2Kg 塑膠罐或根據客戶要求，如需要詳細資料請聯絡 **Feedpool** 客戶服務及銷售部門。

H. 應用示意圖



薄膜開關/軟板線路



電腦鍵盤線路